

证券简称：气派科技

证券代码：688216

## 气派科技股份有限公司

### 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，强化公司主业，进一步巩固和提升竞争优势，拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《气派科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。

本说明中如无特别说明，相关用语具有与《气派科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

#### 一、公司的主营业务

公司主要从事半导体封装、测试业务。经过多年的沉淀和积累，公司已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。同时，公司正逐步开展半导体产业封装中的前端工序晶圆测试业务，以进一步完善公司在半导体封装测试领域的产业布局。

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动发展，注重半导体封装测试技术的研发升级，通过产品迭代更新构筑市场竞争优势。公司掌握了 5G 基站 GaN 射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、FC 封装技术、MEMS 封装技术、大功率碳化硅芯片塑封封装技术等多项核心技术，形成了自身在半导体封装测试领域的竞争优势，在半导体封装测试领域具有较强的竞争实力。

## 二、本次募集资金投向的具体情况

### （一）基本情况

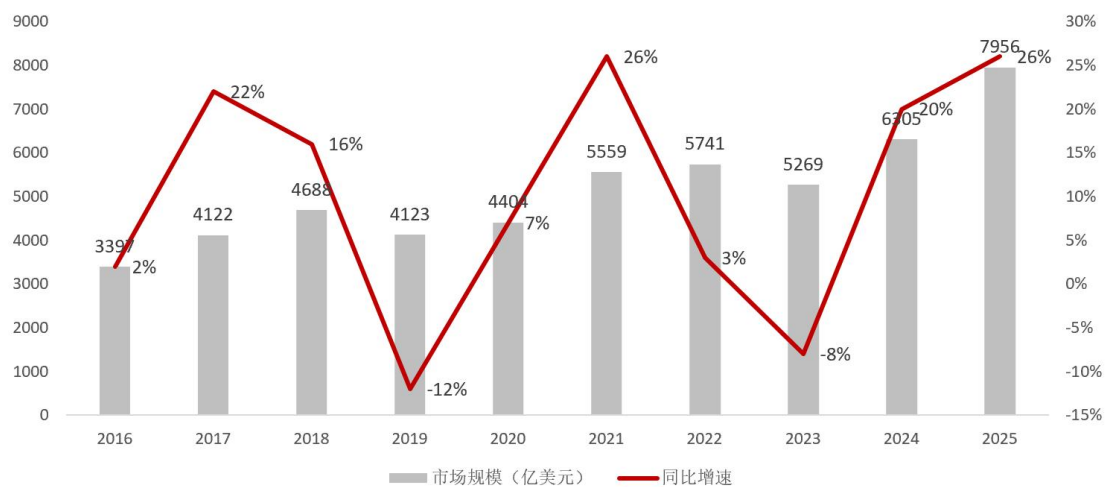
高密度高性能芯片封测项目建设地点位于东莞市石排镇气派科技路1号，拟利用现有厂房并装修改造实施，并配备相应的生产设备，扩大公司封装测试产能。本项目建设完成后，公司将新增 QFN/DFN、DFN（第三代半导体）、FC-Q/DFN、LQFP 等封装测试产能 5.14 亿只/年。项目的建设有利于进一步扩大公司产能，并优化公司产品结构，强化公司竞争力。

### （二）本次募集资金投资项目的必要性分析

#### 1、半导体行业需求持续攀升

近年来，5G 技术、物联网、新能源汽车及人工智能等新兴技术与终端产品加速迭代普及，直接带动全球半导体市场需求持续攀升，行业整体进入高速增长阶段。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2024 年全球半导体市场规模达到 6,305 亿美元，同比增长 20%，受到人工智能相关应用的推动以及计算和数据中心基础设施的持续需求驱动，2025 年全球半导体市场同比强劲增长 26%，达到 7,956 亿美元。

2016-2025 年全球半导体市场规模及增速



数据来源：WSTS

半导体市场规模的持续增长带动集成电路封测市场需求持续攀升,根据 Yole 的相关数据,2014 年至 2024 年,全球半导体封装测试市场销售额由 532 亿美元增长至 899 亿美元。未来,全球半导体封装测试技术将继续向小型化、集成化、低功耗方向发展,在新兴市场和半导体技术进步的共同带动下,附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用,封装测试业市场有望持续向好,2026 年全球封测市场规模将有望达 961 亿美元。

2014-2024 年全球半导体封装测试市场销售额及增长情况



数据来源: Yole

## 2、突破产能瓶颈, 满足下游市场需求

公司深耕半导体封装测试领域多年,已发展成为华南地区规模领先的内资封装测试企业之一。近年来,公司业务规模稳步扩张,产能利用率持续攀升。2023 年至 2025 年,公司封装测试产量分别为 89.74 亿只、107.98 亿只、125.38 亿只,对应收入分别为 5.20 亿元、6.24 亿元、7.29 亿元,增速分别为 19.91%和 16.83%,封装测试产品和收入均保持较快增长。2023 年至 2025 年,公司封装测试产能利用率分别为 68.13%、80.57%、88.52%,2025 年全年处于高负荷运行状态。公司现有产能接近饱和已成为制约订单承接与业务扩张的重要因素。若无法及时扩充产能,公司将面临订单交付延迟、客户流失等风险,错失行业发展机遇,进而影响营收规模扩大与市场份额提升。

本次扩产项目公司产品系 DFN/QFN 等系列的中高端产品,应用领域包括人工智能、物联网、智能家居、消费电子等高景气高需求行业,可有效释放产能瓶

颈，满足下游市场需求，提升公司可持续发展能力。

### 3、布局 FC 先进封装形式产品，优化产品结构，提升公司在先进封装测试领域的竞争力

近年来，集成电路终端系统向多任务处理、微型化方向加速演进，持续驱动封装技术向高性能、高密度、高散热、晶圆级、薄型化及小型化迭代升级。在此背景下，FC、SiP、TSV 等先进封装技术的应用场景不断拓展，已成为行业重要发展方向。

当前，日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已较全面地掌握 FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV、Chiplet 等先进封装技术，并实现规模化应用。而公司产品目前仍以 SOP、SOT 等传统封装形式为主，先进封装产品占比相对较低。因此，公司若不能及时强化先进封装领域的产能布局，将难以匹配下游终端市场对先进封装的需求，可能导致核心竞争力弱化、市场份额被挤压，进而面临市场空间持续收窄的风险。基于此，公司优化产品结构，提高先进封装产品占比，是增强公司可持续发展能力的重要举措。本项目建设完成后，将有效提升公司 FC 等先进封装产品的产能布局，助力产品结构优化升级，提升公司在先进封装测试领域的竞争力。

### 4、扩大经营规模，巩固和提升行业竞争地位

当前，国内封装测试市场竞争格局日趋激烈，长电科技、通富微电、华天科技等内资领先企业不仅通过资本市场募集资金扩充产能、进行技术和产品升级，还通过市场化收购兼并实现资源整合与跨越式发展，不断筑牢竞争优势。与此同时，各类外资及合资封测企业也持续加大在中国大陆的产能布局与资金投入，进一步加剧了国内市场的竞争烈度，行业头部集聚效应愈发明显。

公司经过在封测领域多年的积累和拓展，目前已具备一定规模和较强技术实力，但与长电科技、通富微电和华天科技等为典型代表的中国大陆封装测试行业龙头企业相比，仍有较大的提升空间。在当前市场高速发展的态势下，公司如若不能及时扩大自身规模、增强竞争实力，将可能面临市场份额被挤压、客户资源流失的风险。特别是随着下游客户对供应链稳定性和交付能力的要求不断提高，

产能规模已成为客户选择封测供应商的重要考量因素。因此，通过本项目建设扩大生产规模，是公司巩固和提升市场竞争地位的必然选择。

### （三）募集资金投资项目的可行性分析

#### 1、本项目产品具有广阔的市场前景

半导体封测产业与半导体产业景气状况紧密相关，随着半导体景气度全面复苏以及人工智能、数据中心、云计算、物联网、虚拟/增强现实等新兴应用场景的快速发展，全球半导体产业景气度高涨带动半导体封测市场规模持续扩张。根据 Yole 的相关数据，2014-2024 年，集成电路封装测试全球市场规模由 532 亿美元增长至 899 亿美元，复合年增长率（CAGR）达到 5.4%。

根据中国半导体行业协会的数据，从中国大陆市场来看，受益于产业政策支持与下游需求带动，2017-2024 年中国大陆封测市场规模由 1,889.7 亿元增长至 3,336.8 亿元，复合增长率为 8.5%；未来随着全球集成电路产业重心向中国大陆转移，行业将保持稳定增长态势。

综上所述，半导体封测产业广阔的市场空间是本项目的建设基础，项目产品符合行业发展趋势和市场需求，具有良好的市场前景。

#### 2、公司具备的生产组织与质量管理优势为项目产品提供基础保障

封装工艺的功能包括功率分配（电源分配）、信号分配、散热通道、隔离保护和机械支持等，每一项功能都能影响芯片的性能，封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的 PCB（印制电路板）的设计和制造。因此，良好的生产组织与质量管控能力，是封测企业重要的竞争力之一。

公司深耕半导体封测领域多年，积累了丰富的产品矩阵与工艺经验，封装产品覆盖 MEMS、FC、CPC、SOP 等多种系列。公司自成立伊始便坚持提升生产管理与质量管理水平，打造了一支经验丰富的研发技术团队和高素质生产管理人才队伍。在生产组织方面，公司依托成熟的生产经验与稳定可靠的技术工艺，采用柔性化生产模式，可根据客户订单需求灵活调整生产计划与产品结构，快速完成生产线调试与组合，实现高效率、多批次、小批量的柔性生产，显著提升市场

快速响应能力。此外，公司建立并严格执行全流程质量管理体系，不断完善作业规范、质量控制及工艺管理制度，已通过 ISO9001:2015 质量管理体系、IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系及 ISO22301 业务连续性管理体系认证等，为产品质量稳定与持续经营提供坚实保障。

### 3、公司具备的技术和人才优势为项目提供技术基础

本次募投项目产品均已正式量产或小批量试生产，募投项目实施具备技术基础。

半导体封装测试行业属于技术密集型与人才密集型行业，管理团队与核心技术团队是企业持续技术创新、保持核心竞争力的关键要素。封装测试企业需要能够将理论研究与实际生产相结合的专业性人才，才能更好地提升公司的技术水平、研发能力和生产管理能力和，保证生产效率、产品成本与质量、交货期的稳定性，形成竞争优势。

公司专注于半导体封装测试领域，经过多年技术积累与市场深耕，已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，也是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。在人才方面，公司核心技术人员具备多年半导体封测行业从业经验，研发团队熟练掌握半导体封装特性及封装测试生产流程关键技术，有效保障公司产品在质量稳定性、成本控制、规模化交付等方面形成核心竞争优势。目前公司已掌握了 5G 基站 GaN 射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、FC 封装技术、MEMS 封装技术、大功率碳化硅芯片塑封封装技术等多项核心技术，形成了自身在半导体封装测试领域的竞争优势，在半导体封装测试领域具有较强的竞争实力。

综上，公司具有的技术和人才优势助力公司在国内半导体封测领域构建较强的综合竞争实力，为项目顺利实施奠定了扎实的技术和人才基础。

### 4、项目概算

本项目总投资 19,812.39 万元，具体构成情况如下：

序号	费用名称	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	19,575.37	98.80%
1.1	建筑工程费	660.00	3.33%
1.1.1	装修工程费	660.00	3.33%
1.2	设备购置及安装费	17,983.21	90.77%
1.3	预备费	932.16	4.70%
2	铺底流动资金	237.02	1.20%
3	项目总投资	19,812.39	100.00%

### 5、项目实施主体、建设地点、建设周期

本募投项目实施主体为广东气派科技有限公司，项目建设地点位于广东省东莞市石排镇气派科技路1号，项目建设期为3年。

### 6、项目备案与环境保护评估情况

本项目拟利用现有土地和厂房。截至本预案公告日，本项目备案手续和相关环评手续正在办理中。

### 7、项目的效益分析

经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。项目实施后，能够为公司带来稳定的现金流入。

## 三、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

### （一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司主要从事半导体封装、测试业务。经过多年的沉淀和积累，公司已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过11,000.00万元（含本数），扣除发行费用后净额全部用于高密度高性能芯片封测项目，本项目建设完成后，公司将新增QFN/DFN、DFN（第三代半导体）、FC-QFN/DFN、LQFP等中高端封装测试产能5.14亿只/年，系围绕公司主营业务展开。根据《上海证

券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》，公司属于第五条规定的“新一代信息技术领域”。因此，本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。

## （二）募投项目实施将促进公司科技创新水平的提升

本次发行有助于公司优化产品结构，提高先进封装产品占比，是增强公司可持续发展能力的重要举措，提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化。未来公司将进一步提升现有核心业务的技术水平，开发出更具竞争力的封装测试产品，巩固、扩大自身的竞争优势，强化自身品牌和科创属性。

## 四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《注册管理办法》等有关规定的要求。

气派科技股份有限公司董事会

2026年4月28日